

興大與 PIDA 合辦「半導體及光電先進封裝與智慧製造」產學交流會

國內外大廠齊聚加值

[感謝本校秘書室媒體公關組提供資料](#)

為加深中部地區在半導體及光電先進封裝與智慧製造領域發展，廠商與學校鏈結，2月24日由中興大學研究發展處、中興大學工學院的傑出校友和師長們，出錢出力與光電科技工業協進會(PIDA)共同發起舉辦「半導體及光電先進封裝與智慧製造產學交流會」。

邀請國內指標性半導體廠商聯發科技、矽品精密工業、菱生精密工業、友威科技、辛耘企業與政美應用，以及國外大廠美商科磊(KLA)與臺灣村田(muRata)齊聚現場，與中興大學工學院系所教授互相經驗分享與激盪交流半導體封裝先進技術和智慧製造的實踐與挑戰，現場超過百位產業界專家及師生踴躍參與。而立法院副院長、興大校友總會理事長蔡其昌也蒞臨致詞，表達對母校和臺中地區發展半導體先進封裝產業的支持。

近期包含歐盟、美國都紛紛喊出發展半導體產業，國際市場競爭激烈，而中興大學每年更培育近千名相關系所的學生，如何讓這些年輕學子更加了解半導體產業，進而達到「放眼全球、接軌國際」，本次產學交流會最重要的目的，希望藉由產學交流會方式，串接與國內外半導體廠商在先進封裝製程技術、測試設備與應用人工智慧進行機台設備之預診與監控等領域之研究成果，期望未來共同合作開發更多前瞻應用技術與商機，提升技術競爭力與培育專業人才。

中興大學宋振銘研發長表示，半導體產業是國家發展重要基石，興大非常榮幸與PIDA及產業先進們共同籌辦此次盛會，為中區產學研之攜手合作跨出一大步。中興大學為中部唯一頂尖大學，在半導體相關領域有強大師資與研究能量，近期也即將推出包含先進半導體IC設計、元件、封裝，以及著重在第三代半導體應用的半導體與綠色科技等學程，結合業界的力量培育人才，對台灣半導體永續發展做出貢獻。

中興大學工學院楊明德院長表示，產業的發展需要跨領域的技術與資源，特別是進步快速且生命週期短的半導體產業，對工程技術與人才的需求更是殷切。工學院有不同領域的系所、師資和設備，可根據產業需求進行研究及培育人才，希望透過這樣的交流平台，媒合產業需求和教授專長，進一步延伸產學合作與人才培育，深化產業技術，也厚植產業的競爭力。

臺灣半導體產業擁有相對完整的產業供應鏈，面對目前科技產業人才缺乏的挑戰，中興大學持續培育關鍵科技人才，深耕半導體及光電先進封裝與智慧製造的研究，透過光電科技工業協進會搭起的產學合作平台，希望產業資源與中興大學豐沛的學術研究能量，並在前瞻技術能力與人才培育扎根，進而提升中興大學學生未來就業

競爭力。